

2008年3月期 連結決算概要

	2007年3月期 (自 2006年 4月 1日 至 2007年 3月31日)		2008年3月期 (自 2007年 4月 1日 至 2008年 3月31日)		前期比 増(減)	
	金額	率	金額	率	金額	率
売上高	6,923	100.0	6,877	100.0	△ 45	△0.7
半導体売上高	6,597		6,533		△ 65	△1.0
営業損益	△ 286	△4.1	51	0.7	337	—
税引前損益	△ 354	△5.1	△ 33	△ 0.5	321	—
当期純損益	△ 415	△6.0	△ 160	△ 2.3	255	—
1株当たり当期純損益	円		円		円	%
基本的	△ 336.04		△ 129.52		206.52	—
希薄化後	△ 336.04		△ 129.52		206.52	—

設備投資額	1,059	億円	561	億円	△ 497	△47.0
減価償却費等	830		751		△ 79	△9.5
研究開発費	1,318		1,123		△ 195	△14.8
米ドル為替レート(円)	117	円	116	円		
ユーロ為替レート(円)	149	円	161	円		

	2007年3月31日 現在		2008年3月31日 現在		前期末比 増(減)	
	金額	率	金額	率	金額	率
総資産	6,959	億円	6,163	億円	△ 796	△11.4
株主資本	2,651		2,271		△ 379	△14.3
従業員数	23,982	人	23,110	人	△ 872	△3.6

(注) ①億円未満を四捨五入して表示しております。

②当社の連結決算は「米国会計基準」に準拠しておりますが、営業損益は「売上高」から「売上原価」「研究開発費」および「販売費および一般管理費」を差し引いたものを表示しております。

③1株当たり当期純損益は米国財務会計基準書第128号「1株当たり利益」に基づいて算出しております。

④株主資本の金額は、米国会計基準に基づいて表示しております。



2008年3月期 決算短信〔米国会計基準〕

2008年5月14日

上場会社名 NECエレクトロニクス株式会社 上場取引所 東証一部
 コード番号 6723 URL <http://www.necel.co.jp/>
 代表者 (役職名) 代表取締役社長 (氏名) 中島 俊雄
 問合せ先責任者 (役職名) コーポレートコミュニケーション部長 (氏名) 遠藤 泰三 TEL (044) 435 - 1664
 定時株主総会開催予定日 2008年6月26日
 有価証券報告書提出予定日 2008年6月26日

(百万円未満四捨五入)

1. 2008年3月期の連結業績 (2007年4月1日~2008年3月31日)

(1) 連結経営成績

(%表示は対前期増減率)

	売上高		営業利益		税引前利益		当期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
2008年3月期	687,745	△0.7	5,094	—	△3,252	—	△15,995	—
2007年3月期	692,280	7.2	△28,557	—	△35,375	—	△41,500	—

	1株当たり 当期純利益	希薄化後 1株当たり当期純利益	株主資本 当期純利益率	総資産 税引前利益率	売上高 営業利益率
	円 銭	円 銭	%	%	%
2008年3月期	△129.52	△129.52	△6.5	△0.5	0.7
2007年3月期	△336.04	△336.04	△14.5	△4.9	△4.1

(参考) 持分法投資損益 2008年3月期 △207百万円 2007年3月期 △468百万円

(注)① 1株当たり当期純利益は米国会計基準書第128号「1株当たり利益」に基づいて算出しております。

② 当社の連結決算は「米国会計基準」に準拠しておりますが、営業利益は「売上高」から「売上原価」「研究開発費」および「販売費および一般管理費」を差し引いたものを表示しております。

(2) 連結財政状態

	総資産	株主資本	株主資本比率	1株当たり株主資本
	百万円	百万円	%	円 銭
2008年3月期	616,304	227,138	36.9	1,839.20
2007年3月期	695,886	265,068	38.1	2,146.32

(注) 株主資本の金額は、米国会計基準に基づいて表示しております。

(3) 連結キャッシュ・フローの状況

	営業活動による キャッシュ・フロー	投資活動による キャッシュ・フロー	財務活動による キャッシュ・フロー	現金および現金同等物 期末残高
	百万円	百万円	百万円	百万円
2008年3月期	43,262	△37,769	△22,985	165,472
2007年3月期	66,731	△78,497	△15,273	185,372

2. 配当の状況

(基準日)	1株当たり配当金			配当金総額 (年間)	配当性向 (連結)	株主資本 配当率 (連結)
	中間期末	期末	年間			
	円 銭	円 銭	円 銭	百万円	%	%
2007年3月期	0.00	0.00	0.00	—	—	—
2008年3月期	0.00	0.00	0.00	—	—	—
2009年3月期 (予想)	0.00	0.00	0.00		—	

3. 2009年3月期の連結業績予想 (2008年4月1日~2009年3月31日)

(%表示は、通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率)

	売上高		営業利益		税引前利益		当期純利益		1株当たり 当期純利益
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%	円 銭
第2四半期連結累計期間	335,000	△4.6	3,000	62.0	0	—	△2,000	—	△16.19
通 期	685,000	△0.4	10,000	96.3	4,000	—	0	—	0.00

4. その他

(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う子会社の異動） 無

(2) 連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更
(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更に記載されるもの)

- ① 会計基準等の改正に伴う変更 有
② ①以外の変更 無

(注) 詳細は、24 ページ「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」をご覧ください。

(3) 発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む）	2008年3月期	123,500,000株	2007年3月期	123,500,000株
② 期末自己株式数	2008年3月期	2,039株	2007年3月期	1,445株
③ 期中平均株式数	2008年3月期	123,498,165株	2007年3月期	123,498,823株

(参考) 個別業績の概要

1. 2008年3月期の個別業績(2007年4月1日～2008年3月31日)

(1) 個別経営成績

(%表示は対前期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		当期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
2008年3月期	588,999	△1.2	△26,801	—	△29,505	—	△28,417	—
2007年3月期	596,141	17.6	△49,234	—	△55,192	—	△77,521	—

	1株当たり 当期純利益	潜在株式調整後 1株当たり当期純利益
	円 銭	円 銭
2008年3月期	△230.10	—
2007年3月期	△627.71	—

(2) 個別財政状態

	総資産	純資産	自己資本比率	1株当たり純資産
	百万円	百万円	%	円 銭
2008年3月期	508,282	237,765	46.8	1,924.78
2007年3月期	553,904	266,162	48.0	2,154.97

(参考) 自己資本 2008年3月期 237,706百万円 2007年3月期 266,136百万円

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

業績見通しは、現時点で入手可能な情報に基づき当社が判断しており、潜在的なリスクや不確実性が含まれております。そのため、実際の業績は、今後の様々な要因の変化により、業績見通しと乖離する可能性があります。

1. 経営成績

(1) 経営成績に関する分析

① 当期の経済および事業環境

当期の世界経済を概観しますと、年度前半は堅調に推移いたしました。米国のサブプライム住宅ローン問題に起因する金融市場の混乱に加えて、原油をはじめとする資源価格の高騰や為替相場の乱高下による影響もあり、年度末にかけて停滞傾向が強まりました。

米国経済は、最終的に雇用調整が始まるなど、年度を通じて景気は悪化方向にあり、年度前半は堅調に推移した欧州経済についても、年度後半は減速となりました。また、高成長を維持してきたアジア経済についても、年度後半のアジア株式市場の株価下落が景気の減速を示唆する状況となりました。このような世界経済全体の環境のもと、輸出依存度と資源の輸入依存度が高い日本の経済についても、年度後半になると景況感が悪化し、先行きの不透明感が強まる状態に陥りました。

半導体市場についても、年度前半は低成長ながら堅調に推移したものの、年度後半にかけては世界経済の景気減速に伴うクリスマス商戦の不調や、メモリ等の価格下落などにより、半導体市場全体の出荷の伸び率は縮小しました。とりわけ、当期は、従前であれば、大きく需要拡大が期待できる北京オリンピック開催前の時期にもかかわらず、需要の盛り上がり目立った動きがなく、厳しい事業環境となりました。

② 当期の連結業績

(単位 億円)

	前期	当期	増(減)	
売上高	6,923	6,877	△45	△0.7%
営業損益	△286	51	337	-
税引前損益	△354	△33	321	-
当期純損益	△415	△160	255	-
米ドル為替レート(円)	117	116	-	-
ユーロ為替レート(円)	149	161	-	-

当期の連結売上高は6,877億円と、前期と比べ45億円(0.7%)の減少となりました。

当期は、ゲーム機向け半導体の売上が大幅に増加したことや、デジタルテレビ向け半導体の売上増などにより、民生用電子機器分野の売上が前期と比べ大幅に増加したことに加え、マイクロコントローラの売上が好調であったことなどにより、自動車および産業機器分野や多目的・多用途ICの売上も前期と比べ増加したものの、携帯電話端末向けLCD(液晶ディスプレイ)ドライバICやメモリ等の売上減により、通信機器分野の売上が前期と比べて大幅に減少したことや、プリンタ向け半導体等の売上減により、コンピュータおよび周辺機器分野の売上も前期と比べ減少したことなどによる結果、売上高全体としては0.7%の減少となりました。

連結営業損益は51億円の利益で、前期と比べ337億円改善し、黒字転換いたしました。これは、原価率の改善に加えて、研究開発の効率化をはじめとする固定費削減施策を遂行したことなどによるものです。

連結税引前損益は33億円の損失で、前期と比べ321億円の改善、連結当期純損益は、米国子会社の繰延税金資産に対して評価引当金を計上した結果、160億円の損失となり、前期と比べ255億円の改善となりました。

③ 製品分野別連結売上高実績

製品分野別の連結売上高は次のとおりです。

(単位 億円)

	前期	当期	増(減)	
			増(減)	増(減)率
通信機器分野	996	704	△293	△29.4%
コンピュータおよび周辺機器分野	1,237	1,194	△44	△3.5%
民生用電子機器分野	1,208	1,345	138	11.4%
自動車および産業機器分野	1,061	1,133	72	6.8%
多目的・多用途 I C	890	896	7	0.8%
ディスクリート・光・マイクロ波	1,206	1,261	55	4.6%
半 導 体 計	6,597	6,533	△65	△1.0%
そ の 他	325	345	19	5.9%
合 計	6,923	6,877	△45	△0.7%

◆ 通信機器分野 売上高 704億円(前期比29.4%減)

通信機器分野の当期の売上高は、前期と比べ293億円(29.4%)減少し、704億円となりました。

当分野には、ルータ、携帯電話基地局などのブロードバンド・ネットワーク機器向け半導体や携帯電話端末向け半導体が含まれます。

当期は、携帯電話端末向け半導体の売上が前期と比べ減少しました。これは、携帯電話端末向けLCDドライバICやメモリの売上が販売数量の減少や価格下落等により大幅に減少したことなどによるものです。

◆ コンピュータおよび周辺機器分野 売上高 1,194億円(前期比3.5%減)

コンピュータおよび周辺機器分野の当期の売上高は、前期と比べ44億円(3.5%)減少し、1,194億円となりました。

当分野には、サーバおよびワークステーション向け半導体やパソコンおよびパソコン周辺機器向け半導体が含まれます。

当期は、パソコン周辺機器向け半導体の売上が前期と比べ減少しました。これは、液晶テレビやパソコン用モニター向けLCDドライバICの売上が需要の拡大により増加したものの、プリンタ向け半導体の売上が大幅に減少したことなどによるものです。

◆ 民生用電子機器分野 売上高 1,345億円(前期比11.4%増)

民生用電子機器分野の当期の売上高は、前期と比べ138億円(11.4%)増加し、1,345億円となりました。

当分野には、家電製品向け半導体やゲーム機向け半導体が含まれます。

当期は、デジタルカメラ向け半導体の売上が前期と比べ大幅に減少したものの、ゲーム機向け半導体やデジタルテレビ向け半導体の売上が前期と比べ増加したことに加え、青色DVD(デジタル多用途ディスク)機器向け半導体の出荷が本格化したことなどにより、当分野全体としては大幅な売上増となりました。

◆ 自動車および産業機器分野 売上高 1,133 億円 (前期比 6.8%増)

自動車および産業機器分野の当期の売上高は、前期と比べ 72 億円 (6.8%) 増加し、1,133 億円となりました。

当分野には、自動車向け半導体、FA (ファクトリー・オートメーション) 機器などの産業機器向け半導体が含まれます。

当期は、産業機器向け半導体の売上が前期と比べ減少したものの、自動車向け半導体の売上が、自動車の電子化の進展や、当社が注力する自動車向けマイクロコントローラが特に日本や欧州でシェアを拡大したことなどにより、前期と比べ大幅に増加しました。

◆ 多目的・多用途 IC 売上高 896 億円 (前期比 0.8%増)

多目的・多用途 IC の当期の売上高は、前期と比べ 7 億円 (0.8%) 増加し、896 億円となりました。

当分野には、汎用マイクロコントローラ、ゲートアレイ、多用途の SRAM などが含まれます。

当期は、「オール・フラッシュ・マイコン」の製品ラインアップ拡充による市場シェア拡大などにより、汎用マイクロコントローラの売上が前期と比べ増加しました。

◆ ディスクリート・光・マイクロ波 売上高 1,261 億円 (前期比 4.6%増)

ディスクリート・光・マイクロ波の当期の売上高は、前期と比べ 55 億円 (4.6%) 増加し、1,261 億円となりました。

当分野には、ダイオード、トランジスタなどのディスクリート半導体、光通信や DVD 向け光半導体、携帯電話端末などに使用されるマイクロ波半導体が含まれます。

当期は、ディスクリート半導体の売上が主にパソコン向けや自動車向けに好調であったことなどにより前期と比べ増加したことに加え、化合物半導体の売上也放送通信機器向けを中心に前期と比べ増加しました。

◆ その他 売上高 345 億円 (前期比 5.9%増)

その他の当期の売上高は、前期と比べ 19 億円 (5.9%) 増加し、345 億円となりました。

当分野には、主に当社の販売子会社が行っている LCD パネルの再販など、半導体以外の製品の販売事業が含まれます。

同事業は、当社グループの主力事業ではありません。

④ 所在地別連結売上高実績

当社および当社の子会社の所在地別に分類した連結売上高は次のとおりです。

(単位 億円)

		前期	当期	増(減)	
日	本	3,773	3,702	△71	△1.9%
米	国	675	583	△92	△13.6%
欧	州	889	959	70	7.9%
ア	ジ	1,586	1,633	47	3.0%
ア	ジア				
合	計	6,923	6,877	△45	△0.7%

(注) 当社の子会社の所在地において、日本および米国以外の各区分に属する国は以下のとおりです。

欧州：ドイツ、アイルランド、英国

アジア：中国、シンガポール、台湾、マレーシア、韓国、インドネシア

◆ 日本 売上高 3,702 億円 (前期比 1.9%減)

日本では、ゲーム機向け半導体やデジタルテレビ向け半導体の売上が増加したものの、携帯電話端末向けLCDドライバICや、デジタルカメラやプリンタ向け半導体などの売上が減少したことなどにより、当期の売上高は、前期と比べ71億円(1.9%)減少し、3,702億円となりました。

◆ 米国 売上高 583 億円 (前期比 13.6%減)

米国では、有線通信機器向け半導体の売上が増加したものの、携帯電話端末向けメモリや、ゲーム機向け半導体の売上が減少したことなどにより、当期の売上高は、前期と比べ92億円(13.6%)減少し、583億円となりました。

◆ 欧州 売上高 959 億円 (前期比 7.9%増)

欧州では、自動車向け半導体や汎用マイクロコントローラの売上が増加したことなどにより、当期の売上高は、前期と比べ70億円(7.9%)増加し、959億円となりました。

なお、前期および当期の欧州における売上高に占める大部分は、ドイツに本社を置く子会社によるものであります。

◆ アジア 売上高 1,633 億円 (前期比 3.0%増)

アジアでは、汎用マイクロコントローラや、バッテリー駆動機器向けを中心にディスクリット半導体の売上が増加したことなどにより、当期の売上高は、前期と比べ47億円(3.0%)増加し、1,633億円となりました。

なお、前期および当期の、中国に本社を置く子会社における売上高は、それぞれ983億円、931億円であります。

⑤ 次期の見通し

半導体市場においては、昨年後半からの世界経済の景気後退による先行き不透明感が強まっており、これに加えて急速な円高の進行や原油をはじめとする資源価格の高騰、原材料価格の高騰など、当社を取り巻く事業環境はより一層厳しいものとなっております。

このような環境のもと、当社グループにおいては、2007年2月に策定した経営方針に基づき、様々な施策を実行することにより、半導体市場の好・不況に左右されず着実に収益を生み出すことのできる強靱な事業体質を構築すべく、全社を挙げて経営の効率化に取り組んでおります。

次期の見通しに関しては、連結売上高は、当期に比べほぼ横這いの6,850億円、うち、半導体売上高についても、当期に比べほぼ横這いの6,500億円を見込んでおります。これは、半導体の出荷数量は増加するものの、円高の影響により売上高の伸びが抑制される見込みであることによるものです。

連結営業利益については、円高による利益悪化要因があるものの、半導体の生産数量増による原価率の改善や、固定費削減など経営の効率化等により100億円を見込んでおります。また、連結税引前利益は40億円、連結当期純利益は0億円を見込んでおります。

(2009年3月期の連結業績予想)

		(当期比)
売上高	6,850億円	△0.4%
(半導体売上高)	6,500億円	△0.5%
営業利益	100億円	96.3%
税引前利益	40億円	—
当期純利益	0億円	—

なお、通期業績見通しにあたっては、1米ドル100円、1ユーロ160円を前提としております。

当業績見通しは、現時点で入手可能な情報に基づき当社が判断しており、潜在的なリスクや不確実性が含まれております。そのため、実際の業績は、今後の様々な要因の変化により、当業績見通しと乖離する可能性があります。

(2) 財政状態に関する分析

① 総資産および株主資本

(連結財政状態)		(単位 億円)	
	2007年3月末	2008年3月末	増(減)
総資産	6,959	6,163	△796
株主資本	2,651	2,271	△379
株主資本比率(%)	38.1	36.9	△1.2
1株当たり株主資本(円)	2,146	1,839	△307
有利子負債	1,360	1,166	△194

当期末の総資産残高は、6,163億円で、前期末と比べ796億円の減少となりました。これは、設備投資の削減や減価償却などにより有形固定資産が371億円減少したことや、借入金の返済などにより現金および現金同等物が199億円減少したことに加え、連結当期純損失を計上したことなどにより株主資本が大幅に減少したことなどによるものです。

株主資本は、2,271億円で、前期末と比べ379億円の減少となりました。これは、連結当期純損失を160億円計上したことや、その他の包括損益が220億円悪化したことなどによるものです。

株主資本比率は、株主資本の減少により前期末と比べ1.2ポイント低下しました。

有利子負債は、借入金の返済などにより、前期末と比べ194億円減少し1,166億円となりました。

② キャッシュ・フロー

(連結キャッシュ・フローの状況)		(単位 億円)		
	前期	当期	増(減)	
営業活動によるキャッシュ・フロー	667	433	△235	
投資活動によるキャッシュ・フロー	△785	△378	407	
フリー・キャッシュ・フロー	△118	55	173	
財務活動によるキャッシュ・フロー	△153	△230	△77	
為替相場変動の現金および現金同等物への影響額	16	△24	△40	
現金および現金同等物純増加(減少)額	△254	△199	55	
現金および現金同等物期首残高	2,111	1,854	△257	
現金および現金同等物期末残高	1,854	1,655	△199	

当期の営業活動によるキャッシュ・フローは、連結当期純損失の計上や買掛金の減少などがあったものの、減価償却費等の計上額が751億円であったことなどにより、433億円の収入となりました。

投資活動によるキャッシュ・フローは、フォトマスク事業の譲渡や所有設備の売却による収入があったものの、有形固定資産の購入による支払が622億円であったことなどにより、378億円の支出となりました。

これらの結果、フリー・キャッシュ・フローは55億円の収入となりました。

また、財務活動によるキャッシュ・フローは、借入金の返済等により 230 億円の支出となりました。

以上に為替相場の変動による影響額を考慮した、現金および現金同等物純増加(減少)額は 199 億円の減少となり、現金および現金同等物期末残高は 1,655 億円となりました。

(3) 利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当

当社は、企業価値の最大化の観点から、新製品の研究開発、設備投資などのために内部留保を重視し、強靱な財務体質の実現を目指しながら、利益の一部を配当してまいります。各期の配当の金額につきましては、連結および単独の利益剰余金の状況、連結の利益の状況、翌期以降の利益見通しおよびキャッシュ・フローの状況などを考慮し決定いたします。

当社は、中間配当と期末配当の年 2 回の剰余金の配当を行うことを基本方針としております。これらの剰余金の配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会であります。また、当社は、「取締役会の決議により、毎年 9 月 30 日を基準日として、中間配当を行うことができる。」旨を定款に定めております。

当期(2008 年 3 月期)の配当につきましては、連結・単独業績とも当期純損失を計上するに至ったこと、また連結・単独とも累積損失の状況にあることから、これを見送らせていただきます。

次期(2009 年 3 月期)の配当につきましては、連結業績において当期純損益の黒字回復を目指すものの、配当を再開するにはまだ十分な水準とならないことから、中間・期末ともこれを見送らせていただく予定であります。できるだけ早期に配当を再開すべく、業績の改善および財政状況の改善に努めてまいります。

(4) 事業等のリスク

当社グループが認識している事業等のリスクのうち、主要なものは次のとおりであります。

① 市況の変動による影響

当社グループは、常に市況の動向を見極めながら事業活動を遂行しておりますが、世界各国の景気循環や最終製品の需要の変化などに起因する、半導体市場の循環的な市況変動の影響を完全に回避することは困難であるため、市況が下降した局面においては、売上の減少や、工場稼働率の低下による原価率の悪化により、大幅に収益が悪化する可能性があります。

② 為替の変動による影響

当社グループの経営成績および財政状態は、為替相場の変動によって影響を受けます。当社グループは、こうした為替相場の変動による影響を回避または軽減するため、先物為替予約をはじめとして様々な対策を講じておりますが、為替相場が大きく変動した場合、外貨建の売上、外貨建の購入、海外工場の生産コスト等が影響を受ける可能性があります。また、当社の外貨建の資産・負債を日本円に換算すること、さらに、海外子会社における外貨建表示の財務諸表を日本円に換算することによっても、当社グループの資産・負債および収益・費用は変動します。

③ 自然災害等のリスク

地震、台風、洪水等の自然災害、事故、テロをはじめとした当社グループがコントロールできない事由によって、所有する半導体工場等の設備が深刻な損害を被り、その操業を停止せざるを得なくなる可能性があります。特に、当社グループは、地震が発生する確率が世界の平均より高いと考えられる地域に重要な設備を保有しており、地震の発生時には、その影響により工場等の操業を停止せざるを得ない可能性があります。当社グループでは、地震による損害発生に備えて地震保険に加入しておりますが、それにより損害を全額補填できるという保証はありません。

④ 競争による影響

半導体事業は熾烈な競争状態にあり、当社グループは、製品の性能、構成、価格、品質等の様々な点で、国内外の多くの同業他社との激しい競争にさらされております。当社グループでは、競争力の維持強化に向けて、先端技術の開発、設計のプラットフォーム化、原価低減の推進等の様々な施策に取り組んでおりますが、競争力を維持することができなかった場合、製品のマーケットシェアが低下し、当社グループの業績に悪影響を及ぼす可能性があります。また、熾烈な市場競争により、製品の販売価格が急激に低下し、原価低減では補い切れずに、粗利益率の悪化に見舞われる可能性があります。

⑤ 製品の欠陥、異常または故障に関するリスク

当社グループでは、様々な施策を通じて、ソフトウェアを含む製品の品質向上に取り組んでおりますが、これらの製品に用いられる技術の高度化、顧客における製品の使用方法の多様化等により、出荷時に発見できない欠陥、異常または故障が製品に存在する場合があります。顧客の最終製品に組み込まれた後に当該欠陥、異常または故障が発見される可能性があります。この場合、製品の返品や交換、損失の補償、製品の採用打ち切りなどの結果につながり、当社グループの業績に悪影響を及ぼす可能性があります。こうした事態に備えて、当社グループでは、生産物賠償責任保険、生産物回収費用保険等の保険に加入しておりますが、それにより損失を全額補填できるという保証はありません。

⑥ 長期性資産の減損のリスク

当社グループは、有形固定資産など多くの長期性資産を保有しておりますが、長期性資産の連結貸借対照表計上額について、当該資産から得られる将来のキャッシュ・フローによって、資産の残存価額を回収することができるかどうかを定期的に検討しています。当該資産が十分なキャッシュ・フローを生み出さない場合は、長期性資産につき減損を認識しなければならない可能性があります。

⑦ 情報管理に関するリスク

当社グループは、事業活動の遂行に関連して、多数の秘密情報を有しております。これらの情報については、秘密情報の管理方法につき定める規程に基づき管理しておりますが、予期せぬ事態により情報が流出するおそれがあり、そのような事態が生じた場合、顧客の信用や社会的信用の低下を招き、当社グループの業績に悪影響を及ぼす可能性があります。

⑧ 環境問題に関するリスク

当社グループは、「NECエレクトロニクス環境方針」のもと、地球温暖化、大気汚染、産業廃棄物、有害物質の規制強化、土壌汚染等、多様化・複合化する環境問題に対して、環境負荷の低減につとめておりますが、今後、当社グループの事業活動に関連して、過失の有無にかかわらず環境問題に対して法的、もしくは社会的責任を負う可能性があり、そのような事態が生じた場合、その対応のために多額の費用負担が発生する可能性や、当社グループの社会的信用の低下を招く可能性があります

⑨ 法的事項等

当社グループの製品は、広範囲にわたる技術を使用しておりますが、こうした技術が第三者の保有する知的財産権を侵害しているとの主張が当社グループに対してなされる可能性があります。このような主張を受けた場合、当社グループおよび顧客を防御するため、訴訟対応費用を含む多額の費用が発生する可能性があります。それに加えて、最終的には巨額の損害賠償を命じられたり、経済合理性を超えた技術使用料の請求により、その技術を利用できなくなったりする可能性があります。

また、当社グループの事業は、環境、安全、公正取引等に関する日本国および諸外国の様々な法令や政府の規制の適用を受けております。当社グループは、こうした法令・規制を遵守すべく対応しておりますが、万一法令・規制の違反を理由とする訴訟や法的手続において、当社グループに不利な判断がなされた場合、当社グループの業績に悪影響を及ぼす可能性があります。

当社の米国子会社である NEC Electronics America, Inc. は、米国 DRAM 業界における独占禁止法（反トラスト法）違反行為による損害賠償を求める直接購入者（過去において当社グループから直接 DRAM を購入した顧客）からの複数の民事訴訟（集団訴訟）の被告になっておりましたが、これらの集団訴訟は和解により終了しました。現在は、集団訴訟から離脱した一部の顧客と係争中または日本電気(株)とともに和解交渉中です。また、NEC Electronics America, Inc. は、独占禁止法違反行為による損害賠償を求める間接購入者（DRAM が含まれた製品の購入者）からの複数の集団訴訟および米国の複数の州の司法長官による訴訟の被告にもなっております。

当社グループは、欧州においても DRAM 業界における競争法違反行為の可能性について欧州委員会が行う調査に協力して、日本電気(株)とともに情報提供を行っております。

さらに、当社グループは、これらに加え (i) SRAM 業界における独占禁止法違反の可能性に関する米国司法省および欧州委員会の調査、(ii) SRAM をはじめとした半導体業界における韓国独占禁止法違反の可能性に関する韓国公正取引委員会の調査、ならびに (iii) TFT 液晶ディスプレイ業界における独占禁止法違反の可能性に関する米国司法省、欧州委員会、韓国公正取引委員会およびカナダ競争当局の調査の対象となっております。また、NEC Electronics America, Inc. および当社は、SRAM 業界における独占禁止法違反行為による損害賠償を求める複数の民事訴訟の被告となっており、NEC Electronics America, Inc. は、TFT 液晶ディスプレイ業界における独占禁止法違反行為による損害賠償を求める複数の民事訴訟の被告となっております。

これらの独占禁止法違反を理由とする民事訴訟、和解交渉および当局による種々の調査については、現時点では結論は出ておりませんが、日本電気(株)とも協議のうえ、米国での DRAM に係る民事訴訟および和解交渉に関し今後発生する可能性のある諸費用の見積額を引き当てております。

2. 企業集団の状況

当社企業グループの連結子会社（25社）を事業分野別に記載すると次のとおりとなります。

生産会社	販売会社
山形日本電気(株) (注①)	NECエレクトロニクス・ヨーロッパ
福井日本電気(株) (注②)	NECエレクトロニクスUK (注⑧)
関西日本電気(株) (注②)	NECエレクトロニクス台湾
山口日本電気(株) (注③)	NECエレクトロニクス・シンガポール
九州日本電気(株) (注③)	NECエレクトロニクス中国 (注⑨)
NECセミコンパッケージ・ソリューションズ(株) (注③)	NECエレクトロニクス香港
NECファブサブ(株) (注④)	NECエレクトロニクス上海
NECエレクトロニクス・アメリカ (注⑤)	NECエレクトロニクス韓国
NECセミコンダクターズ・アイルランド (注⑥)	NECコンパウンドセミコンダクターデバイス香港 (注⑩)
NECセミコンダクターズ・シンガポール	
NECセミコンダクターズ・マレーシア	
NECセミコンダクターズ・インドネシア (注⑦)	
首鋼NECエレクトロニクス	

設計会社	その他
NECマイクロシステム(株)	日本電子ライト(株) (株)近畿分析センター

(注①) 山形日本電気(株)は、2008年4月1日付でNECセミコンダクターズ山形(株)に商号変更しました。

(注②) 関西日本電気(株)は、2008年4月1日付で福井日本電気(株)を吸収合併し、NECセミコンダクターズ関西(株)に商号変更しました。

(注③) 九州日本電気(株)は、2008年4月1日付で山口日本電気(株)およびNECセミコンパッケージ・ソリューションズ(株)を吸収合併し、NECセミコンダクターズ九州・山口(株)に商号変更しました。

(注④) NECファブサブ(株)は、2007年2月27日付で大日本印刷(株)との間で締結した株式譲渡契約に基づき、2007年5月1日付でフォトマスク事業を新設分割して新会社を設立し、2007年6月1日付で新会社株式のすべてを同社に譲渡しました。

(注⑤) NECエレクトロニクス・アメリカは、生産および販売を担当しております。

(注⑥) NECセミコンダクターズ・アイルランドは、2006年9月をもって生産および出荷活動を終了しました。

(注⑦) NECセミコンダクターズ・インドネシアは、2007年10月をもって生産および出荷活動を終了しました。

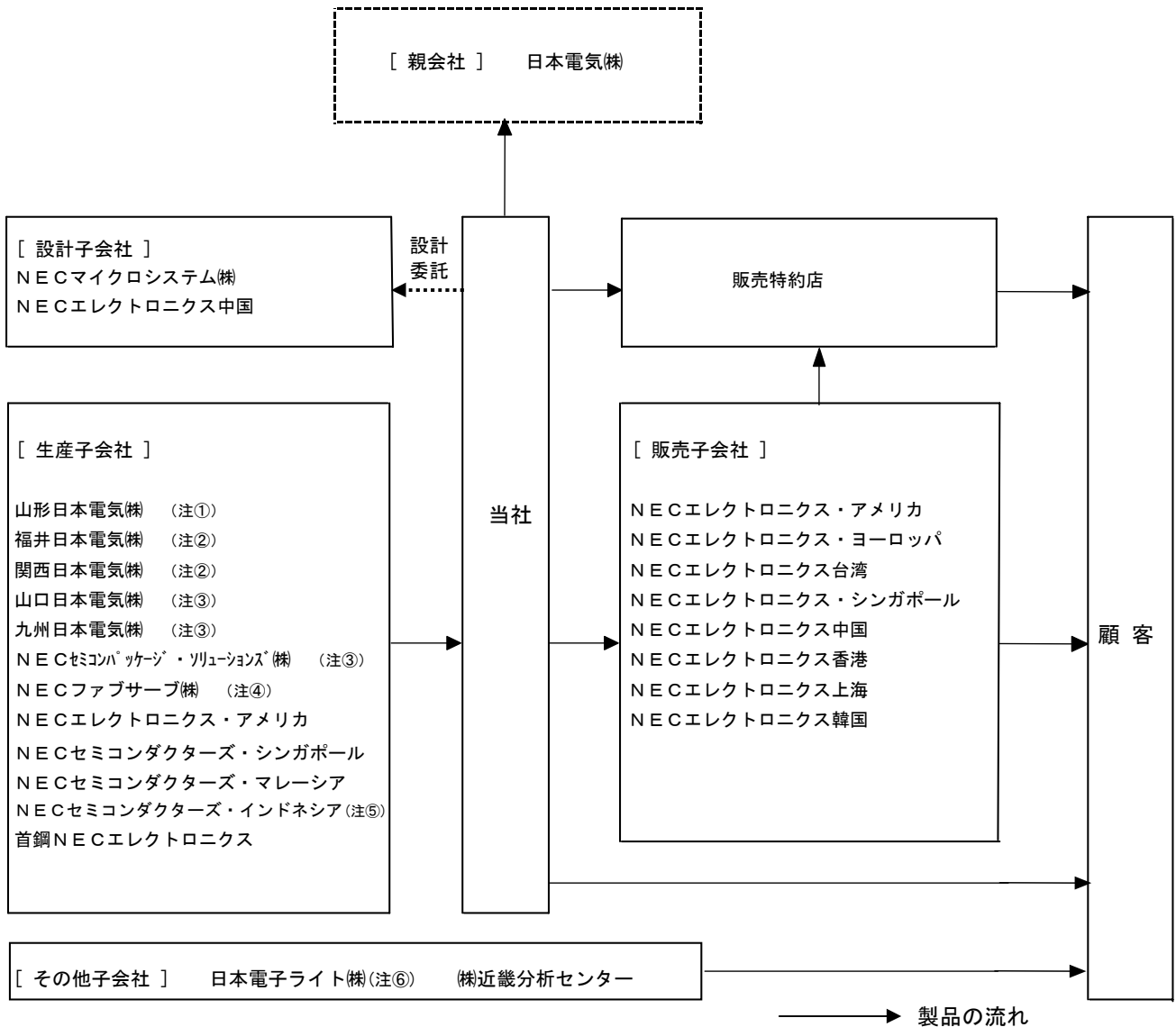
(注⑧) NECエレクトロニクスUKは、休眠会社です。

(注⑨) NECエレクトロニクス中国は、販売および設計を担当しております。

(注⑩) NECコンパウンドセミコンダクターデバイス香港は、2006年11月1日付でNECエレクトロニクス香港に事業統合され、販売活動を終了しました。

【 事業系統図 】

当社グループにおける主要な関係会社の事業の系統は、概ね図のとおりです。



(注①) 山形日本電気(株)は、2008年4月1日付でNECセミコンダクターズ山形(株)に商号変更しました。
 (注②) 関西日本電気(株)は、2008年4月1日付で福井日本電気(株)を吸収合併し、NECセミコンダクターズ関西(株)に商号変更しました。
 (注③) 九州日本電気(株)は、2008年4月1日付で山口日本電気(株)およびNECセミコンパッケージ・ソリューションズ(株)を吸収合併し、NECセミコンダクターズ九州・山口(株)に商号変更しました。
 (注④) NECファブサーブ(株)は、2007年2月27日付で大日本印刷(株)との間で締結した株式譲渡契約に基づき、2007年5月1日付でフォトマスク事業を新設分割して新会社を設立し、2007年6月1日付で新会社株式のすべてを同社に譲渡しました。
 (注⑤) NECセミコンダクターズ・インドネシアは、2007年10月をもって生産および出荷活動を終了しました。
 (注⑥) 日本電子ライト(株)の販売は、関西日本電気(株)を経由して販売している製品も含まれています。

3. 経営方針

(1) 会社の経営の基本方針

当社グループは、次の方針に基づき、半導体のグローバルリーディングカンパニーを目指し、企業価値・株主価値の増大に努めてまいります。

- S o C (システム・オン・チップ)、マイクロコンピュータ、個別半導体という3つの製品群を主力事業とし、自動車・産業機器、民生機器向けに注力します。
- 開発と製造の緊密な連携により、新たな力・価値を創り出します。
- 開発・製造・サポートまで一貫責任を持つことにより、「お客様の信頼」に応えます。
- 新たな価値を創出する製品群や分野を開拓・展開し、「社会の信頼」に応えます。

(2) 目標とする経営指標

当社グループは、総資産利益率・株主資本利益率の向上のためには、売上高に対する利益率を改善することが最重要と考えており、できるだけ早期に連結の売上高営業利益率を二桁のレベルに向上させるよう取り組んでまいります。また、2007年2月に策定した経営方針を着実に実行することにより、半導体の市況悪化時にも収益を生み出すことのできる強靱な事業体質を構築すべく、全社を挙げて取り組んでまいります。

(3) 中長期的な会社の経営戦略

上記の基本方針の実現のため、中期的な経営戦略として、次の施策を実行してまいります。

① 開発と製造を一貫化した製品群ごとの事業運営

当社グループの主力製品はS o C、マイクロコンピュータ、個別半導体の3製品群から構成されています。従来、当社は機能別組織体制を採用していましたが、これら3製品群ごとにビジネスユニット化し、損益管理を強化するとともに、生産子会社についてもビジネスユニット単位に再編致しました。この製品別組織体制により、それぞれ開発から製造・サポートまでの一貫化によるコスト・品質・デリバリの競争力を一層強化することが可能になり、開発と製造の緊密な連携による最先端 LSI の超短期量産立上げや歩留り向上など成果が着実にでてきております。今後もこの取り組みを強化することで当社グループの競争力強化を図ってまいります。

② 注力分野へのフォーカスによる製品競争力の強化

当社グループは、自動車・産業機器分野と民生機器分野を注力分野と位置づけております。自動車・産業機器分野向け半導体では高信頼性と長期安定供給が不可欠であり、また民生機器分野向け半導体では画像処理技術、低消費電力技術が求められることなど、当社グループがこれまで培った強みが十分に発揮できる事業特性環境にあると考えております。

当社グループは、既にこれらの分野において世界的に業界をリードするお客様との良好なビジネス関係を有しておりますが、今後も、開発リソースを自動車・産業、民生機器分野にフォーカスすることにより、さらなる競争力の強化を図ってまいります。

③ お客様と社会の信頼に応える企業

当社グループにとって、開発サポート力、開発納期の遵守、量産品の品質維持・向上、不具合に対する迅速な対応、安定的な供給等、これらについての継続的な取り組みは、お客様から長期的な評価をいただけるものであり、競合他社との持続的な差異化が図れる価値でもあります。お客様のニーズに応じて持続的差異化が図れる競争力を高めることが「お客様の信頼」をえることとなります。また、地球環境の保全や、安全・安心な生活や社会となることが今後ますます求められる中、当社グループの強みである低消費電力半導体や高品質半導体は、これらの進展に必ず貢献できる事業だと考えており、これらを追求することにより「社会の信頼」にも応えることができると考えています。

当社グループは、半導体のグローバルリーディングカンパニーを目指し、「お客様の信頼」と「社会の信頼」に応える企業として、今後も事業運営をおこなってまいります。

(4) 会社の対処すべき課題

当社グループでは、当期の後半にみられた厳しい事業環境は、当分の間は継続することを覚悟し、そのような環境下でも着実に収益を生み出すべく、次の事項につき、対処すべき課題として取り組んでまいります。

① 急速な円高の進行を踏まえたコスト構造再構築の加速

当社グループでは、全世界の顧客に幅広く半導体を供給しており、売上高に占める外貨建売上の比率が年々上昇する傾向にあります。その一方で、当社グループは開発と製造の緊密な連携を競争力の源泉とするため、半導体ウエハの処理工程（前工程）の拠点を半導体の開発拠点に近い日本国内を中心に配置していることから、総コストに占める円建の比率が高くなっており、その結果、売上とコストの通貨比率がアンバランスになっています。

そのため、円高が急速に進行する局面では、円換算した際の売上が為替相場の変動分目減りし、一方で円建のコストは変わらないことから、円換算に伴う売上の減少がそのまま粗利益率の悪化につながる可能性があります。

当社グループでは、このような売上とコストの通貨比率の差を少しでも縮小し、為替相場の変動による影響を軽減すべく、今後、外貨建での資材調達や半導体の組立・検査工程（後工程）の拠点の海外移管を加速してまいります。また、前工程の拠点についても、従来から製造ラインの統廃合や個々の製造ラインの規模拡大による製造効率の改善を進めていますが、これを一層加速し、人件費、減価償却費、用力費などの固定的な経費が円建であっても、世界の競合他社に対抗できる競争力の高いコスト構造の再構築を急いでまいります。

② 開発資源の集中化による競争力の強い製品作りと損益分岐点の管理強化の両立

当社グループでは、当期においては、売上に依存しない収益性の改善を目標に掲げ、固定的な経費の大幅な削減により、損益分岐点の引き下げに注力した結果、当面の目標であった連結営業損益の黒字化を達成しました。

しかしながら、固定的な経費の中には、将来の成長に向けた製品開発のための研究開発費も含まれており、今後、こうした将来への先行投資と足もとの費用削減の間のバランスをいかにとっていかかが重要な経営課題となってまいります。

当社グループでは、過去、先行投資の負担が業績悪化を招いた一つの要因となった経緯もあり、今後もしばらくは、売上高に対する研究開発費の比率を抑制していく計画です。しかし、同時に、売上と収益の拡大を牽引する競争力の強い製品を生み出すべく、「世界シェア 10%以上の製品群を育成し、更に世界シェア 20%以上、そして世界トップシェアを目指す」という目標のもと、マーケティングの強化により、開発資源投入の「選択と集中」を更に進めて、強い競争力や成長力が期待できる製品に開発人員と費用を集中的に投入してまいります。

その際には、できるだけ早いタイミングで、製品の将来性を見極めを行っていくことが重要になりますが、半導体事業は、製品開発から量産製品の売上がピークに達するまでの時間差が非常に大きいいため、早いタイミングで見極めを行うのは難しい面があります。当社グループでは、このような難しさはあるものの、市場や顧客のニーズと競争環境を見極めて、製品の開発段階から資源投入の「選択と集中」を推進することこそが、競争力の強い製品作りと損益分岐点の管理強化を両立させる最善の道と確信し、その実行に努めてまいります。

③ 海外売上比率の拡大

世界の半導体市場においては、日本は世界トップクラスの半導体消費地でありますが、近年、日本以外のアジア市場、特に中国の市場拡大が急速に進んでおり、中国、アジア市場でいかに売上シェアの拡大を図っていくかが今後の半導体企業の成長を左右するといっても過言ではない状況になっています。

このような市場環境の変化を受け、当社グループでも中国、アジア市場の営業拠点の整備を進めるとともに、現地の顧客サポートのための技術員を大幅に増員してまいりました。しかしながら、中国、アジア市場向けに需要が旺盛な半導体は、欧米や日本国内向けとは異なる性能、機能または価格水準が要求される場合が多く、現在、当社グループでは中国、アジア市場に最も適した製品群を必ずしも十分に持っていないのが実情です。

今後、当社グループでは、中国、アジア市場向けの営業拠点の整備と、販売員および営業技術員の増員を更に進めるとともに、現地の需要に対応した製品の開発を強化することにより、急成長を続ける中国、アジア市場での売上シェアを高め、当社グループの海外売上比率 50%以上の早期達成に努めてまいります。

(5) 企業の社会的責任

当社グループは、2004年6月に、経営指針となる「NECエレクトロニクスグループ企業行動憲章」を制定するとともに、CSR推進委員会を設置するなど、全社的なCSR (Corporate Social Responsibility: 企業の社会的責任) 推進体制を整えました。2005年4月には、個人情報保護法の全面施行を受け、規程の見直しや社内への周知徹底など、個人情報保護の推進体制を整備しました。また、当社グループでは、持続可能な社会の実現に向けて組織が発行する報告書の世界的な基準「GRIサステナビリティガイドライン」に沿って、CSRレポート、アニュアル・レポート、環境経営報告書の3冊の報告書による情報開示を行っております。

地域に密着した社会貢献活動としては、従来から行っている水源林保護活動や地域の清掃活動に加え、2006年10月から地元の小学生たちに電子・電気に関心を深めてもらうことを目的として、半導体を活用した電子工作教室を開催するなど、地域社会との積極的な交流を図っております。

当社グループは、次の憲章に基づき、良き企業市民として社会的責任を果たすことが継続的な企業価値・株主価値の増大につながると考えております。

NECエレクトロニクスグループ企業行動憲章

私たちNECエレクトロニクスグループは、健全な事業活動をとおして、お客様、株主・投資家の皆様、お取引先、従業員をはじめとするすべての関係者から信頼される存在となることを目指しています。

そのため、良き企業市民として法令を守って誠実に行動し、以下の指針に基づいて社会的責任を果たしていくとともに、高い技術力を基盤とした魅力ある半導体ソリューションの提供に取り組んでまいります。

- お客様志向
最適かつ高品質のソリューション提供をとおして、お客様の満足向上を追求し、お客様からの揺るぎない信頼を獲得します。
- 誠実で透明な企業活動
公平、公正かつ誠実で透明性の高い企業活動を推進するとともに、その活動内容の積極的な公開に努めます。
- 地域社会、国際社会への貢献
グローバルカンパニーとして、国や地域の歴史、文化、慣習、人権を尊重し、地域社会、国際社会に貢献します。
- 地球環境の保全
製品の開発、生産、販売、使用、廃棄にいたるまでのライフサイクルにおいて、環境負荷を低減し、持続可能な社会の発展に寄与します。
- 誇りある企業文化
従業員一人ひとりの個性を尊重し、その資質、能力が最大限に発揮される、活力ある組織を実現します。

連結通期

比較連結損益計算書

(単位 百万円)

科 目	2007年3月期 (自 2006年 4月 1日) (至 2007年 3月31日)		2008年3月期 (自 2007年 4月 1日) (至 2008年 3月31日)		前 期 比 増(減)
		対売上 高比率		対売上 高比率	
売 上 高	692,280	% 100.0	687,745	% 100.0	△ 4,535
売 上 原 価	502,086	72.5	485,683	70.6	△ 16,403
研 究 開 発 費	131,751	19.0	112,300	16.3	△ 19,451
販 売 費 お よ び 一 般 管 理 費	87,000	12.6	84,668	12.4	△ 2,332
営 業 損 益	△ 28,557	△ 4.1	5,094	0.7	33,651
営 業 外 収 益	10,913	1.6	6,053	0.9	△ 4,860
受 取 利 息 お よ び 配 当 金	1,929		2,152		223
雑 収 益	8,984		3,901		△ 5,083
営 業 外 費 用	17,731	2.6	14,399	2.1	△ 3,332
支 払 利 息	698		741		43
雑 損 失	17,033		13,658		△ 3,375
税 引 前 損 益	△ 35,375	△ 5.1	△ 3,252	△ 0.5	32,123
法 人 税 等	5,105	0.7	12,285	1.8	7,180
少 数 株 主 損 益 (控 除)	552	0.1	251	0.0	△ 301
持 分 法 に よ る 投 資 損 益	△ 468	△ 0.1	△ 207	△ 0.0	261
当 期 純 損 益	△ 41,500	△ 6.0	△ 15,995	△ 2.3	25,505

(注) 当社の連結決算は「米国会計基準」に準拠しておりますが、営業損益は「売上高」から「売上原価」「研究開発費」および「販売費および一般管理費」を差し引いたものを表示しております。

比較連結貸借対照表

(単位 百万円)

科目	2007年3月末	2008年3月末	前期比 増(減)
(資産の部)			
流動資産	378,206	344,115	△ 34,091
現金および現金同等物	185,372	165,472	△ 19,900
受取手形および売掛金	99,543	96,352	△ 3,191
たな卸資産	79,165	75,839	△ 3,326
その他の流動資産	14,126	6,452	△ 7,674
固定資産	317,680	272,189	△ 45,491
投資等	7,154	4,565	△ 2,589
有形固定資産	296,231	259,151	△ 37,080
その他の資産	14,295	8,473	△ 5,822
資産合計	695,886	616,304	△ 79,582
(負債・資本の部)			
流動負債	222,960	179,715	△ 43,245
短期借入金	20,603	2,394	△ 18,209
支払手形および買掛金	132,467	107,311	△ 25,156
その他の流動負債	69,890	70,010	120
固定負債	203,023	204,275	1,252
社債および長期借入金	115,427	114,207	△ 1,220
未払退職および年金費用	71,535	74,460	2,925
その他の固定負債	16,061	15,608	△ 453
少数株主持分	4,835	5,176	341
資本	265,068	227,138	△ 37,930
資本金	85,955	85,955	—
資本剰余金	281,039	281,073	34
利益剰余金	△ 98,901	△ 114,896	△ 15,995
その他の包括損益累計額	△ 3,017	△ 24,984	△ 21,967
自己株式	△ 8	△ 10	△ 2
負債、少数株主持分および 資本合計	695,886	616,304	△ 79,582
有利子負債残高	136,030	116,601	△ 19,429
株主資本比率	38.1 %	36.9 %	△ 1.2 %
D/E レシオ	0.51 倍	0.51 倍	— 倍

【その他の包括損益累計額内訳】

・外貨換算調整額	10,502	1,913	△ 8,589
・年金負債調整額	△ 15,937	△ 27,737	△ 11,800
・有価証券未実現損益	2,418	840	△ 1,578

(注) 2007年3月末の連結貸借対照表の一部の金額について、2008年3月末の表示に合わせて細替え再表示しております。

比較連結資本勘定計算書

2007年3月期(2006年4月1日～2007年3月31日)

(単位 百万円)

	資本金	資本 剰余金	利益剰余金	その他の 包括損益 累計額	自己株式	合計
期首残高	85,955	281,014	△ 57,369	△ 1,342	△ 7	308,251
ストックオプションに係る報酬費用		25				25
包括損益						
当期純損益			△ 41,500			△ 41,500
その他の包括損益(税効果調整後)						
外貨換算調整額				2,789		2,789
最小年金負債調整額				△ 878		△ 878
有価証券未実現損益				△ 3,336		△ 3,336
デリバティブ未実現損益				12		12
包括損益 合計						△ 42,913
基準書第158号の適用による調整 (税効果調整後)				△ 262		△ 262
海外子会社の決算期変更による影響額			△ 32			△ 32
自己株式の取得(取得原価)					△ 1	△ 1
期末残高	85,955	281,039	△ 98,901	△ 3,017	△ 8	265,068

2008年3月期(2007年4月1日～2008年3月31日)

(単位 百万円)

	資本金	資本 剰余金	利益剰余金	その他の 包括損益 累計額	自己株式	合計
期首残高	85,955	281,039	△ 98,901	△ 3,017	△ 8	265,068
ストックオプションに係る報酬費用		34				34
包括損益						
当期純損益			△ 15,995			△ 15,995
その他の包括損益(税効果調整後)						
外貨換算調整額				△ 8,589		△ 8,589
年金負債調整額				△ 11,800		△ 11,800
有価証券未実現損益				△ 1,578		△ 1,578
包括損益 合計						△ 37,962
自己株式の取得(取得原価)					△ 2	△ 2
期末残高	85,955	281,073	△ 114,896	△ 24,984	△ 10	227,138

連結通期

比較連結キャッシュ・フロー計算書

(単位 百万円)

期 項 目	2007年3月期 (自 2006年 4月 1日 至 2007年 3月31日)	2008年3月期 (自 2007年 4月 1日 至 2008年 3月31日)	前 期 比 増(減)
<u>I. 営業活動によるキャッシュ・フロー</u>			
当期純損益	△ 41,500	△ 15,995	25,505
営業活動により増加したキャッシュ(純額)への調整			
減価償却費等	82,960	75,067	△ 7,893
受取手形および売掛金の(増加)減少額	15,985	△ 3,710	△ 19,695
たな卸資産の(増加)減少額	△ 9,333	856	10,189
支払手形および買掛金の増加(減少)額	16,171	△ 17,309	△ 33,480
その他	2,448	4,353	1,905
計	66,731	43,262	△ 23,469
<u>II. 投資活動によるキャッシュ・フロー</u>			
有形固定資産売却額	39,803	20,653	△ 19,150
有形固定資産購入額	△ 121,126	△ 62,188	58,938
有価証券売却額	3,660	—	△ 3,660
貸付金の(増加)減少額	511	△ 2	△ 513
その他	△ 1,345	3,768	5,113
計	△ 78,497	△ 37,769	40,728
フリー・キャッシュ・フロー (I + II)	△ 11,766	5,493	17,259
<u>III. 財務活動によるキャッシュ・フロー</u>			
社債および借入金の増加(減少)額	△ 13,074	△ 20,456	△ 7,382
その他	△ 2,199	△ 2,529	△ 330
計	△ 15,273	△ 22,985	△ 7,712
為替相場変動の現金および現金同等物への影響額	1,595	△ 2,408	△ 4,003
現金および現金同等物純増加(減少)額	△ 25,444	△ 19,900	5,544
海外子会社の決算期変更による現金および現金同等物の減少	△ 244	—	244
現金および現金同等物期首残高	211,060	185,372	△ 25,688
現金および現金同等物期末残高	185,372	165,472	△ 19,900

連結第4四半期

比較連結損益計算書

(単位 百万円)

科 目	2007年3月期 第4四半期 (自 2007年 1月 1日) (至 2007年 3月31日)		2008年3月期 第4四半期 (自 2008年 1月 1日) (至 2008年 3月31日)		前年同期比 増(減)
		対売上 高比率		対売上 高比率	
売 上 高	171,390	% 100.0	165,994	% 100.0	△ 5,396
売 上 原 価	131,017	76.4	120,497	72.6	△ 10,520
研 究 開 発 費	35,180	20.5	24,594	14.8	△ 10,586
販 売 費 お よ び 一 般 管 理 費	22,993	13.5	20,663	12.5	△ 2,330
営 業 損 益	△ 17,800	△ 10.4	240	0.1	18,040
営 業 外 収 益	1,014	0.6	874	0.5	△ 140
受 取 利 息 お よ び 配 当 金	439		531		92
雑 収 益	575		343		△ 232
営 業 外 費 用	9,496	5.5	7,841	4.7	△ 1,655
支 払 利 息	53		117		64
雑 損 失	9,443		7,724		△ 1,719
税 引 前 損 益	△ 26,282	△ 15.3	△ 6,727	△ 4.1	19,555
法 人 税 等	1,831	1.1	5,426	3.2	3,595
少 数 株 主 損 益 (控 除)	168	0.1	5	0.0	△ 163
持 分 法 に よ る 投 資 損 益	△ 78	△ 0.0	131	0.1	209
当 期 純 損 益	△ 28,359	△ 16.5	△ 12,027	△ 7.2	16,332

(注) 当社の連結決算は「米国会計基準」に準拠しておりますが、営業損益は「売上高」から「売上原価」「研究開発費」および「販売費および一般管理費」を差し引いたものを表示しております。

連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

1. 連結範囲および持分法の適用に関する事項

連結子会社数 25社
持分法適用会社数 1社

2. 重要な会計方針

(1) 連結財務諸表の作成基準

当社の連結財務諸表は、米国会計基準に準拠して作成しております。

(2) たな卸資産の評価方法および評価基準

主として先入先出法による低価法を採用しております。

(3) 有価証券の評価方法および評価基準

米国財務会計基準審議会基準書（以下、「基準書」）第115号「負債証券投資および持分証券投資の会計」を適用しております。

売却可能有価証券は、決算日の市場価格等に基づく時価法により評価しております。

（評価差額は全部資本直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定しております。）

(4) 固定資産の減価償却方法

有形固定資産の減価償却方法は、主として定率法を採用しております。

無形固定資産の減価償却方法は、主として定額法を採用しております。

(5) 引当金の計上基準

① 貸倒引当金

貸倒引当金は、過去の貸倒損失の実績ならびに回収可能性に疑義がある受取手形および売掛金の個別評価に基づいて計上しております。

② 退職給付引当金

基準書第87号「年金に関する事業主の会計」および基準書第158号「確定給付型年金およびその他の退職後給付制度に関する事業主の会計」を適用しております。

(6) 会計方針の変更

当連結会計年度より基準書第109号「法人所得税の会計処理」の解釈指針第48号「法人税における不確実性に関する会計処理」を適用しております。

セグメント情報

(1) 製品分野別売上高

(単位 百万円)

	2007年3月期 (自 2006年 4月 1日 至 2007年 3月31日)		2008年3月期 (自 2007年 4月 1日 至 2008年 3月31日)			前期比 増(減)
		構成比 (%)	構成比 (%)	前期比 増減率 (%)		
通信機器分野	99,641	14.4	70,350	10.2	△ 29.4	△ 29,291
コンピュータおよび周辺機器分野	123,714	17.9	119,352	17.4	△ 3.5	△ 4,362
民生用電子機器分野	120,757	17.4	134,546	19.6	11.4	13,789
自動車および産業機器分野	106,097	15.3	113,320	16.5	6.8	7,223
多目的・多用途IC	88,961	12.9	89,643	13.0	0.8	682
ディスクリート・光・マイクロ波	120,563	17.4	126,064	18.3	4.6	5,501
半導体計	659,733	95.3	653,275	95.0	△ 1.0	△ 6,458
その他	32,547	4.7	34,470	5.0	5.9	1,923
合計	692,280	100.0	687,745	100.0	△ 0.7	△ 4,535

<参考> プラットフォーム別売上高

当社は、製品分野別売上高に加えて、事業特性の類似するプラットフォーム別の売上高も開示しております。

(単位 百万円)

	2007年3月期 (自 2006年 4月 1日 至 2007年 3月31日)		2008年3月期 (自 2007年 4月 1日 至 2008年 3月31日)			前期比 増(減)
		構成比 (%)	構成比 (%)	前期比 増減率 (%)		
SoCプラットフォーム	259,249	37.5	251,295	36.5	△ 3.1	△ 7,954
MCUプラットフォーム	168,421	24.3	180,113	26.2	6.9	11,692
個別半導体	232,063	33.5	221,867	32.3	△ 4.4	△ 10,196
半導体計	659,733	95.3	653,275	95.0	△ 1.0	△ 6,458
その他	32,547	4.7	34,470	5.0	5.9	1,923
合計	692,280	100.0	687,745	100.0	△ 0.7	△ 4,535

(注)

SoC(システム・オン・チップ)プラットフォーム: ASIC(特定用途向け集積回路)、ASSP(特定用途向け標準品)、メモリ
MCU(マイクロコンピュータ)プラットフォーム: マイクロコントローラ、カーオーディオコントローラ
個別半導体: 表示ドライバ、アナログIC、ディスクリート半導体、化合物半導体

連結通期

(2) 所在地別売上高

(単位 百万円)

	2007年3月期		2008年3月期		
	(自 2006年 4月 1日 至 2007年 3月 31日)		(自 2007年 4月 1日 至 2008年 3月 31日)		
		構成比 (%)		構成比 (%)	前期比 増減率 (%)
日 本	377,298	54.5	370,238	53.8	△ 1.9
米 国	67,458	9.8	58,256	8.5	△ 13.6
欧 州	88,908	12.8	95,936	14.0	7.9
ア ジ ア	158,616	22.9	163,315	23.7	3.0
合 計	692,280	100.0	687,745	100.0	△ 0.7

(3) 所在地別営業損益

(単位 百万円)

	2007年3月期		2008年3月期		
	(自 2006年 4月 1日 至 2007年 3月 31日)		(自 2007年 4月 1日 至 2008年 3月 31日)		
		構成比 (%)		構成比 (%)	前期比 増(減) (百万円)
日 本	△ 38,877	—	△ 9,386	—	29,491
米 国	△ 1,006	—	755	—	1,761
欧 州	100	—	2,023	—	1,923
ア ジ ア	11,226	—	11,702	—	476
合 計	△ 28,557	—	5,094	—	33,651

金 融 商 品

(1) デリバティブ

各デリバティブ取引における帳簿価額および公正価値は次のとおりです。

(単位 百万円)

	2007年3月末		2008年3月末	
	帳簿価額	公正価値	帳簿価額	公正価値
デリバティブ取引 為替予約 金利スワップ	157 △ 13	157 △ 13	1,520 -	1,520 -

(2) 市場性ある有価証券

市場性ある有価証券について、有価証券の種類ごとの取得価額と時価および未実現損益は次のとおりです。

(単位 百万円)

	2007年3月末	2008年3月末
売却可能有価証券 持分証券		
取得価額	1,933	1,933
時価	5,997	3,345
未実現損益	4,064	1,412

リ ー ス 取 引

当社は、一部の設備については、リース契約による賃借資産を使用しております。オペレーティング・リースに分類される賃借資産の解約不能期間に係る未経過リース料はそれぞれ次のとおりです。

(単位 百万円)

	2007年3月末	2008年3月末
1 年 内	24,281	25,499
1 年 超	50,677	40,555

ストックオプション

決算短信における開示の必要性が大きいと考えられるため開示を省略します。

1株当たり当期純損益

基本的小よび希薄化後1株当たり当期純損益の計算における分母の調整は次のとおりです。

	2007年3月期	2008年3月期	増(減)
	(自2006年4月1日 至2007年3月31日)	(自2007年4月1日 至2008年3月31日)	
当期純損益(単位 百万円)	△ 41,500	△ 15,995	25,505
株式数(単位 株)			
加重平均発行済普通株式数	123,498,823	123,498,165	△ 658
希薄化効果のある証券の影響	—	—	—
希薄化後加重平均発行済普通株式数	123,498,823	123,498,165	△ 658
1株当たり当期純損益(単位 円)			
基本的	△ 336.04	△ 129.52	206.52
希薄化後	△ 336.04	△ 129.52	206.52

逆希薄化効果があるため、希薄化後1株当たり当期純損益の計算には含めておりませんが、将来潜在的に1株当たり損益を希薄化する可能性のある証券は次のとおりです。

(単位 株)

	2007年3月期	2008年3月期	増(減)
	(自2006年4月1日 至2007年3月31日)	(自2007年4月1日 至2008年3月31日)	
転換社債	11,156,100	11,156,100	—
ストックオプション	307,000	72,000	△ 235,000

設備投資額・研究開発費

(単位 百万円)

	2007年3月期	2008年3月期	増(減)
	(自2006年4月1日 至2007年3月31日)	(自2007年4月1日 至2008年3月31日)	
設備投資額	105,865	56,128	△ 49,737
減価償却費等	82,960	75,067	△ 7,893
研究開発費	131,751	112,300	△ 19,451

(注) 設備投資額は、有形固定資産(ソフトウェアを除く)取得額を表示しております。

単 独

比較単独損益計算書

(単位 百万円)

科 目	2007年3月期 (自 2006年4月 1日 至 2007年3月31日)		2008年3月期 (自 2007年4月 1日 至 2008年3月31日)		前 期 比 増 (減)
		対売上 高比率		対売上 高比率	
売 上 高	596,141	% 100.0	588,999	% 100.0	△ 7,143
売 上 原 価	437,205	73.3	427,017	72.5	△ 10,188
販売費および一般管理費	208,170	35.0	188,783	32.1	△ 19,388
営 業 損 益	△ 49,234	△ 8.3	△ 26,801	△ 4.6	22,433
営 業 外 収 益	3,232	0.5	4,288	0.7	1,056
受取利息および配当金	2,796		3,945		1,148
雑 収 益	436		343		△ 93
営 業 外 費 用	9,190	1.5	6,992	1.1	△ 2,199
支 払 利 息	1,398		1,667		269
雑 損 失	7,792		5,325		△ 2,467
経 常 損 益	△ 55,192	△ 9.3	△ 29,505	△ 5.0	25,687
特 別 利 益	10,723	1.8	4,191	0.7	△ 6,532
特 別 損 失	33,976	5.7	4,888	0.8	△ 29,088
税 引 前 当 期 純 損 益	△ 78,445	△ 13.2	△ 30,201	△ 5.1	48,244
法人税、住民税および事業税	△ 3,255	△ 0.6	△ 1,792	△ 0.3	1,463
法 人 税 等 調 整 額	2,331	0.4	8	0.0	△ 2,323
当 期 純 損 益	△ 77,521	△ 13.0	△ 28,417	△ 4.8	49,104

単 独

比較単独貸借対照表

(単位 百万円)

科目	2007年3月末	2008年3月末	前 期 比 増 (減)
(資産の部)			
流 動 資 産	418,240	389,651	△ 28,590
現金および現金同等物	169,421	30,488	△ 138,933
受取手形および売掛金	75,163	67,267	△ 7,896
有 価 証 券	—	121,958	121,958
た な 卸 資 産	24,429	21,876	△ 2,553
短 期 貸 付 金	132,209	127,418	△ 4,791
そ の 他 の 流 動 資 産	17,879	20,646	2,767
貸 倒 引 当 金	△ 860	△ 2	858
固 定 資 産	135,663	118,631	△ 17,032
有 形 固 定 資 産	32,670	24,554	△ 8,115
無 形 固 定 資 産	23,551	19,808	△ 3,743
投 資 そ の 他 の 資 産	79,442	74,269	△ 5,173
投 資 有 価 証 券	239	507	268
関 係 会 社 株 式	65,051	62,737	△ 2,314
そ の 他 の 投 資	14,152	11,025	△ 3,127
資 産 合 計	553,904	508,282	△ 45,622
(負債の部)			
流 動 負 債	170,637	156,623	△ 14,013
支 払 手 形 お よ び 買 掛 金	82,751	76,530	△ 6,222
一 年 以 内 返 済 予 定 長 期 借 入 金	15,000	—	△ 15,000
そ の 他 の 流 動 負 債	72,885	80,094	7,209
固 定 負 債	117,106	113,893	△ 3,213
新 株 予 約 権 付 社 債	110,000	110,000	—
そ の 他 の 固 定 負 債	7,106	3,893	△ 3,213
負 債 合 計	287,742	270,516	△ 17,226
(純資産の部)			
株 主 資 本	266,154	237,735	△ 28,419
資 本 金	85,955	85,955	—
資 本 剰 余 金	257,728	257,728	—
資 本 準 備 金	21,489	21,489	—
そ の 他 資 本 剰 余 金	236,239	236,239	—
利 益 剰 余 金	△ 77,521	△ 105,938	△ 28,417
そ の 他 利 益 剰 余 金	△ 77,521	△ 105,938	△ 28,417
繰 越 利 益 剰 余 金	△ 77,521	△ 105,938	△ 28,417
自 己 株 式	△ 8	△ 10	△ 2
評 価 ・ 換 算 差 額 等	△ 17	△ 28	△ 11
そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金	△ 10	△ 28	△ 19
繰 延 ヘ ッ ジ 損 益	△ 8	—	8
新 株 予 約 権	25	59	34
純 資 産 合 計	266,162	237,765	△ 28,396
負 債 純 資 産 合 計	553,904	508,282	△ 45,622
減価償却累計額 (有形固定資産)	91,410	82,550	△ 8,861
有利子負債残高	125,000	110,000	△ 15,000
自己資本比率	48.0 %	46.8 %	△ 1.2 %
D/E レシオ	0.47 倍	0.46 倍	△ 0.01 倍

単 独

株主資本等変動計算書

前事業年度（自2006年4月1日 至2007年3月31日）

（単位 百万円）

	株主資本						
	資本金	資本剰余金		利益剰余金		自己株式	株主資本合計
		資本準備金	その他資本剰余金	その他利益剰余金			
				特別償却準備金	繰越利益剰余金		
2006年3月31日 残高	85,955	342,346	-	59	△84,677	△7	343,676
事業年度中の変動額							
資本準備金取崩 (注)		△320,857	236,239		84,618		-
特別償却準備金積立 (注)				6,463	△6,463		-
特別償却準備金取崩 (注)				△11	11		-
特別償却準備金取崩				△6,512	6,512		-
当期純損益					△77,521		△77,521
自己株式の取得						△2	△2
株主資本以外の項目の 事業年度中の変動額 (純額)							
事業年度中の変動額合計	-	△320,857	236,239	△59	7,157	△2	△77,522
2007年3月31日 残高	85,955	21,489	236,239	-	△77,521	△8	266,154

	評価・換算差額等			新株 予約権	純資産 合計
	その他 有価証券 評価差額金	繰延ヘッジ 損益	評価・換算 差額等合計		
2006年3月31日 残高	5,747	-	5,747	-	349,423
事業年度中の変動額					
資本準備金取崩 (注)					-
特別償却準備金積立 (注)					-
特別償却準備金取崩 (注)					-
特別償却準備金取崩					-
当期純損益					△77,521
自己株式の取得					△2
株主資本以外の項目の 事業年度中の変動額 (純額)	△5,757	△8	△5,765	25	△5,739
事業年度中の変動額合計	△5,757	△8	△5,765	25	△83,262
2007年3月31日 残高	△10	△8	△17	25	266,162

(注) 2006年6月の定時株主総会における決議事項であります。

単 独

株主資本等変動計算書

当事業年度（自2007年4月1日 至2008年3月31日）

（単位 百万円）

	株主資本					
	資本金	資本剰余金		利益剰余金	自己株式	株主資本合計
		資本準備金	その他資本剰余金	その他利益剰余金 繰越利益剰余金		
2007年3月31日 残高	85,955	21,489	236,239	△77,521	△8	266,154
事業年度中の変動額						
当期純損益				△28,417		△28,417
自己株式の取得					△2	△2
株主資本以外の項目の 事業年度中の変動額 (純額)						
事業年度中の変動額合計	-	-	-	△28,417	△2	△28,419
2008年3月31日 残高	85,955	21,489	236,239	△105,938	△10	237,735

	評価・換算差額等			新株 予約権	純資産 合計
	その他 有価証券 評価差額金	繰延ヘッジ 損益	評価・換算 差額等合計		
2007年3月31日 残高	△10	△8	△17	25	266,162
事業年度中の変動額					
当期純損益					△28,417
自己株式の取得					△2
株主資本以外の項目の 事業年度中の変動額 (純額)	△19	8	△11	34	23
事業年度中の変動額合計	△19	8	△11	34	△28,396
2008年3月31日 残高	△28	-	△28	59	237,765

単 独

(リース取引関係)

1. リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引

(1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額および期末残高相当額

		(単位 百万円)	
		2007年3月末	2008年3月末
建 物			
取得価額相当額	5,739	5,747	
減価償却累計額相当額	886	1,102	
期末残高相当額	4,853	4,645	
機械および装置			
取得価額相当額	227	253	
減価償却累計額相当額	153	138	
期末残高相当額	74	115	
工具器具および備品			
取得価額相当額	14	-	
減価償却累計額相当額	9	-	
期末残高相当額	4	-	
合 計			
取得価額相当額	5,980	6,000	
減価償却累計額相当額	1,049	1,240	
期末残高相当額	4,931	4,759	

(2) 未経過リース料期末残高相当額

		(単位 百万円)	
		2007年3月末	2008年3月末
1	年 内	377	337
1	年 超	3,819	3,580
合	計	4,195	3,917

(3) 支払リース料、減価償却費相当額および支払利息相当額

		(単位 百万円)	
		2007年3月期 (自 2006年4月 1日 至 2007年3月31日)	2008年3月期 (自 2007年4月 1日 至 2008年3月31日)
支 払 リ ー ス 料	898	552	
減 価 償 却 費 相 当 額	479	347	
支 払 利 息 相 当 額	144	126	

(4) 減価償却費相当額の算定方法

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。

(5) 利息相当額の算定方法

リース料総額とリース物件の取得価額相当額との差額を利息相当額とし、各期への配分方法については利息法によっております。

(減損損失について)

当期および前期においてリース資産に配分された減損損失はありません。

2. オペレーティング・リース取引

未経過リース料		(単位 百万円)	
		2007年3月末	2008年3月末
1	年 内	15,617	17,644
1	年 超	36,347	28,175
合	計	51,964	45,819

(有価証券関係)

当期および前期において子会社株式および関連会社株式で時価のあるものはありません。

なお、「金融商品会計に関する実務指針」の改正により、前期まで「現金および現金同等物」として表示していた譲渡性預金を当期から「有価証券」に含めて表示しております。また、現金同等物についても当期から「有価証券」に含めて表示しております。

〔将来予測に関する注意〕

本資料に記載されている当社および連結子会社（以下NECエレクトロニクスと総称します。）の計画、戦略および業績見通しは、将来の予測であって、リスクや不確定な要因を含んでおります。実際の業績等は、様々な要因により、これら見通し等とは大きく異なる結果となりうることをあらかじめご承知願います。実際の業績等に影響を与えうる重要な要因としては、(1)NECエレクトロニクスの事業領域を取り巻く日本、北米、アジア、欧州等の経済情勢、(2)市場におけるNECエレクトロニクスの製品、サービスに対する需要動向や競争激化による価格下落圧力、(3)激しい競争にさらされた市場においてNECエレクトロニクスが引き続き顧客に受け入れられる製品、サービスを供給し続けていくことができる能力、(4)為替レート（特に米ドルと円との為替レート）の変動等がありますが、これら以外にも様々な要因がありえます。また、世界経済の悪化、世界の金融情勢の悪化、国内外の株式市場の低迷等により、実際の業績等が当初の見通しと異なる結果となる可能性もあります。
